

便簽 日期：107年8月22日
 單位：研究發展處
 速別：普通件
 密等及解密條件或保密期限：

計畫業務組 擬辦：

- 一、文陳閱後，公告於電子公佈欄、本組、本處及本校最新消息，並e-mail副知全校教師知照。
- 二、計畫主持人請於校內申請截止日107年10月17日上午10時前於科技部系統完成線上申請作業，並立即填送「國立中興大學申請科技部研究計畫計畫主持人聲明書」至申請單位(系、所、中心)。
- 三、申請單位須於107年10月18日上午10前至科技部系統列印申請名冊(樣張)1份經單位主管核章後，併同「國立中興大學申請科技部研究計畫申請單位切結書」送至研發處計畫業務組，逾期恕不受理。
- 四、另提醒申請者於提出計畫申請案前，務必更新或確認個人資料（職稱請以人事室核發之正式職稱為準）。
- 五、文存。

會辦單位：

第二層決行		
承辦單位	會辦單位	決行
<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;"> 行政組 張譯云 </div>	0822	0842

科技部 函

機關地址：台北市和平東路二段106號
聯絡人：陳怡婷
電話：02-2737-7280
傳真：02-2737-7619
電子信箱：yitchen@most.gov.tw

受文者：國立中興大學

發文日期：中華民國107年8月21日

發文字號：科部產字第1070060412號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：徵求說明書1份(附件1 A09550000Q0000000_107T0P003633_107D2022870-01.doc)

主旨：本部108年度「產學研發聯盟合作計畫-半導體領域試辦計畫」自即日起受理線上申請，請申請機構於107年10月22日(星期一)前，彙整申請者資料並造冊後，函送本部，逾期不予受理，請查照。

說明：

- 一、為簡化申請程序，本次採一階段程序辦理，申請機構免向計畫推薦機構提出構想書及取得「計畫推薦機構證明文件」，改由本部逕依申請人建議之推薦機構，將「科技部送計畫推薦機構之審核資料」（如徵求說明書附件1）送推薦機構協助審核。
- 二、旨揭計畫執行期間自108年1月1日起至108年12月31日止，相關申請事宜如下：
 - (一)申請資格：
 - 1、申請機構(即執行機構)：符合本部補助專題研究計畫作業要點第二點規定者。
 - 2、計畫主持人(申請人)及共同主持人：符合本部補助專題研究計畫作業要點第三點規定者。
 - 3、合作企業：指符合本部補助產學合作研究計畫作業



要點第二點規定者，並應現金出資至少新臺幣一百萬元，且高於向本部申請之補助經費，出資期間並應與本計畫之執行重疊一定期間。

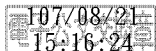
(二)審查作業包括書面初審及會議複審，審查原則如下：

- 1、計畫之研究主題必須具有前瞻性或創新性，以解決未來重要問題為目的；在前瞻性方面應屬於「產業等級」而非「公司等級」，將排除廠商進行國內競爭者現有技術之申請案。
- 2、博士生或博士後參與研究計畫，或業界有吸納計畫內博士生或博士後誘因相關承諾者，將優先考量。

(三)本計畫屬本部「產學案」之數量管制(quota)件數，核定補助後，列入計畫主持人執行計畫件數，共同主持人則不列入計算。

三、系統操作服務專線：本部資訊處(02)2737-7590~92。

正本：專題研究計畫受補助單位（共303單位）

副本：本部產學園區司 

部長陳良基

訂

線

108 年度產學研發聯盟合作計畫
- 半導體領域試辦計畫
徵求說明書



目 錄

壹、背景說明	- 2 -
貳、徵求計畫	- 2 -
參、審查重點	- 3 -
肆、申請辦法及相關資訊.....	- 3 -

108 年度產學研發聯盟合作計畫-半導體領域試辦計畫

徵求說明

壹、背景說明

半導體是全球高科技產業競爭的核心。環顧世界，我國半導體產業發展位居全球半導體的領先地位。106 年，我國晶片設計業排名世界第二，僅次於美國；晶圓代工與晶片封測業則是連續蟬聯世界第一。在半導體領域的研究方面，透過學術界的努力與政府的長期支持下，也具有舉足輕重的國際頂尖研究能量。現在，面對未來科技發展與市場快速成長的契機，還有來自全球競爭對手的嚴峻挑戰，如何透過政府資源的有效運用，進一步鏈結產業界及學術界，共同提升我國半導體產業各領域的競爭力，已成為關鍵課題。

著眼於國家科技、經濟與產業發展的迫切需求，科技部（以下簡稱本部）鼓勵國內產業界與學術界組成產學研發聯盟，透過創新的產學合作模式，引導產業界、學術界結合研發能量，並共同規劃未來關鍵研究主題，促進產學共同投入產業前瞻技術研究，以強化產業發展的關鍵技術研發及智財布局，更協助產業界、學術界共同培育高階研發領導人才。

貳、徵求計畫

為提升我國半導體產業的國際領先地位與競爭實力，本部自 106 年起推動「產學研發聯盟合作計畫」（下稱本計畫），並以半導體領域先行試辦，分為 IC 設計、製造及封測三組。108 年度計畫自 107 年 8 月 21 日（星期二）受理線上申請，請申請計畫主持人至本部網站填寫申請書，路徑如下：<https://www.most.gov.tw/?l=ch>/學術研發服務網登入/學術獎補助申辦及查詢/專題研究計畫(含構想書、申覆、產學、博後著作獎、研究學者)，計畫類別為「產學研發聯盟合作計畫-半導體領域試辦計畫」，並於計畫名稱註明申請組別(如 IC 設計、製造或封測)。申請機構須於 107 年 10 月 22 日（星期一）前彙整申請者資訊及造冊，函送本部，逾期恕不受理。

一、申請資格：

- (一) 申請機構(即執行機構)：符合本部「補助專題研究計畫作業要點」第二點規定者。
- (二) 計畫主持人(申請人)及共同主持人：符合本部「補助專題研究計畫作業要點」第三點規定者。
- (三) 合作企業：符合本部「補助產學合作研究計畫作業要點」第二點規定者，並應提供經費(須為現金出資)投入本計畫研發，以不低於新台幣一百萬元為原則，且高於向本部申請補助經費，並與本計畫之執行重疊一定期間。

二、申請注意事項：

- (一) 計畫申請書應檢附：「科技部送計畫推薦機構之審核資料」（如附件1）、「申請人與企業之合作約定書」（如附件2）。本部將依申請人建議之推薦機構，將「科技部送計畫推薦機構之審核資料」送推薦機構協助審核。前揭之推薦機構，係指我國與本次徵求領域相關之研發聯盟或產業公協會，其設立運作非以接受政府補助為主，且其宗旨應包括促進產學合作、推動產業前瞻技術研發，須確認計畫內容為業界認可之產業前瞻技術研究，還有與吸引業界提供經費投入研發內容之關聯性等。
- (二) 執行機構應於公告受理期間內向本部提出申請，逾期不予受理。
- (三) 計畫書審查期間自申請文件完整交付之次日起三個月內完成；必要時，得予以延長。審查期間不含補正及陳述意見之期間。
- (四) 本部依審查結果核給補助額度。計畫未獲通過補助者，不得提出申覆。
- (五) 計畫執行期間自108年1月1日起開始執行；申請機構得申請多年期計畫（至多三年），本部將依審查結果決定是否核給分年核定多年期計畫。二年期以上計畫，應於當年計畫結束三個月前線上繳交當年計畫執行之精簡進度報告及完整進度報告以供審核，作為下年度之執行依據。

參、審查重點



本部得依計畫之領域性質及特色，聘請企業界、學術研究機構、科技行政單位之學者專家，組成審查小組，負責計畫審查，審查作業包括初審書面審查及複審會議審查，如有必要將安排申請人簡報計畫內容，計畫簡報複審會議時間及地點，將另行通知。審查原則如下：

- 一、計畫團隊應提出未來關鍵研究主題規劃，規劃範疇及產學合作計畫內容須以產業前瞻技術研究為主。
- 二、計畫團隊研究群之執行能力、過去執行產學合作計畫之績效、預期研發成果及產業外溢效果等。
- 三、研究項目及經費需求。
- 四、合作企業之資格、研發能力或潛力、出資、承接計畫成果之意願與承諾（包括技術移轉之協議等）及計畫成果之後續研發能力。
- 五、計畫各年及全程之預期績效。
- 六、吸引業界投入經費說明、權利義務規範等文件。
- 七、申請計畫是否包含下列優先補助參考情事：
 - (一) 博士研究生或博士後研究人員參與研究計畫者，得作為優先補助之審查參考。
 - (二) 業界有吸納計畫內博士班研究生或博士後研究人員誘因相關承諾者，於申請時須一併提供相關證明文件。

肆、申請辦法及相關資訊

一、執行規範：

- (一) 本部得補助下列項目所需費用：

1. 業務費：
 - (1) 研究人力費：
 - A. 專、兼任助理費用及臨時工資。
 - B. 博士後研究人員費用；
 - (2) 耗材、物品、圖書及雜項費用：與本聯盟產學合作計畫直接有關之其他費用等。
 2. 研究設備費。
 3. 管理費。
 4. 國外差旅費：出席國際會議差旅費、國外或大陸地區差旅費。
- (二) 吸引業界投入經費須為現金出資，以不低於新台幣一百萬元為原則，且須高於向本部申請補助經費，得支應下列費用：
1. 研究主持費：由執行機構、主持人及合作企業共同商議。
 2. 業務費：
 - (1) 研究人力費：專、兼任助理、博士後研究人員等研究人力費用。
 - (2) 耗材、物品、圖書及雜項費用。
 3. 研究設備費。
 4. 國外差旅費：出席國際會議差旅費、國外或大陸地區差旅費。
 5. 管理費。
- (三) 博士後研究人員得因執行計畫需要至合作企業參與研發，其工作內容、期間等相關事項由計畫執行機構以契約明定。
- (四) 吸引業界投入經費應高於申請本部補助經費；業界提供經費之計算，得回溯至本計畫當年度徵求公告日當月起至本計畫執行迄日止，且應與本部計畫執行期間重疊一定期間。
- (五) 業界提供經費應使用於計畫之執行或與計畫執行相關之事項，不得任意支用。
- (六) 博士班研究生參與本計畫之研究人力費用，本部至少每月補助 1.5 萬元，業界每月至少投入 1.5 萬元。另業界承諾額外資助博士研究生每位每月新臺幣 1 萬元以上之獎學金者，除原依規定支領研究計畫兼任助理費用外，得依「科技部鼓勵企業參與培育博士研究生試辦方案」，於本計畫補助期間內，每月支領本部專款補助與企業同額之獎學金，且累計補助金額不受本部補助研究計畫兼任助理費用支給標準表之限制，惟本部額外專款補助部分以每月 2 萬元為上限。
- (七) 執行機構應於計畫執行期間結束三個月前向本部完成請領第二期補助經費款項，並檢附提供參與計畫博士研究生獎學金之相關證明文件及業界出資證明文件(須檢附業界全額出資證明文件)。若執行機構未能於請領第二期補助經費款項期間完成請領及未出具前述相關證明文件，或計畫之年度目標未能達成，本部將採分期管考方式，當期未達成約定事項者，終止下期以後之補助經費，並納入本部後續補助之參考。
- (八) 計畫內核給博士後研究人員及博士班研究生經費，如因研究計畫需要，得報經本部同意變更後，於研究人力費內調整運用。
- (九) 執行機構應制定研發成果之規範或整體機制，以加強研發成果之管理、推廣及運用，具體落實推動產學合作之目標。

(十) 合作企業提供研究經費、撥付管理與使用、申請補助項目、其他與計畫相關之權利義務等，應事先以書面約定。

二、研發成果：

本部出資部分歸屬計畫執行機構，其餘成果歸屬由計畫執行機構與合作企業依本部補助產學合作計畫作業要點及相關規定商議約定。

計畫主持人於本計畫執行期間變更所屬單位時，其研發成果之歸屬、管理及運用等相關問題，由變更前、後所屬單位與計畫主持人議定之，並由計畫執行機構函報本部同意後辦理。

計畫執行機構及計畫主持人合作企業運用或推廣研發成果時，在未獲得本部書面同意前，不得在利用研發成果時（包括但不限於產品、商品或服務之公開行銷、推廣或廣告文宣等），引用本部之名稱、部徽或其他表徵；亦不得以其他任何方式表示本部與計畫執行機構及合作企業有任何關連。聯盟會員若違反前開規定，計畫執行機構或計畫主持人應立即通知本部為必要之處理。

計畫執行機構、計畫主持人在研發成果獲准專利後，應明確標示專利證書號數。

結案報告：

- (一) 計畫結束後三個月內，申請機構應向本部繳交計畫研究成果精簡報告及完整結案報告（電子檔），並將產生之研發成果及對產業技術提升之績效等相關資料，辦理登錄作業，並具體展示。
- (二) 二年期以上計畫，應於當年計畫結束三個月前線上繳交當年計畫執行之精簡進度報告及完整進度報告以供審核，作為下年度之執行依據。
- (三) 計畫主持人對前二項計畫之精簡報告、完整報告及研發成果實際運用績效登錄等內容，應負完全責任。如因涉及專利、技術移轉案或其他智慧財產權等，而不宜對外公開者，請勿將其列入精簡報告，原則上本部將公開精簡報告。

四、其他未盡事宜請依「科技部補助產業前瞻技術計畫作業要點」及其他相關規定辦理。

五、計畫申請聯絡窗口

科技部產學研發聯盟合作計畫辦公室

聯絡人：張文馨

電話：02-2737-7008

信箱：wxzhang@narlabs.org.tw

科技部產學及園區業務司

承辦人：陳怡婷

電話：02-2737-7280

信箱：yitchen@most.gov.tw

【科技部送計畫推薦機構之審核資料】

壹、計畫推薦機構之建議(必填)

填寫說明：請填寫計畫推薦機構(限填一機構)之中文完整名稱

貳、企業合作計畫基本資料

填寫說明：若超過一家共同執行公司，請於「共同執行公司一」欄位後增列；若無共同執行公司，相關欄位請留空白或刪除；若有多個學研機構參與，或為多個子計畫之整合型計畫，比照共同執行公司分別列明；計畫總經費請分年列出，若期程超過二年，請自行增列；若為一年期計畫，第二年欄位請留空白或刪除。

計畫名稱	中文			
	英文			
主導公司名稱		(公司全名)		
主導公司計畫主持人		職稱		
共同執行公司一名稱		(公司全名)		
共同執行公司一計畫主持人		職稱		
主導學研機構 / 系所 (單位)				
主導學研機構主持人		職稱		
共同學研機構一 / 系所 (單位)				
共同學研機構一主持人		職稱		
是否規劃博士班研究生 (或博士後研究人員) 共同參與計畫執行				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
計畫總經費	新臺幣	元 (S1 (+ S2 + ...))	計畫期程	年
分年列出	項 目		金 額 (元)	估年度經費百分比
第一年 __年__月__日 至	主導公司投入研發經費 (A1)			%
	共同執行公司一投入研發經費 (B1)			%

__年__月__日			%
	合計 (S1=A1+B1+...)		100 %
第二年 __年__月__日 至 __年__月__日	主導公司投入研發經費 (A2)		%
	共同執行公司一投入研發經費 (B2)		%
			%
	合計 (S2=A2+B2+...)		100 %
主導公司計畫連絡人	姓名：	聯絡電話：	
	E-mail：		
共同執行公司一計畫連絡人	姓名：	聯絡電話：	
	E-mail：		
主導學研機構計畫連絡人	姓名：	聯絡電話：	
	E-mail：		
共同學研機構一計畫連絡人	姓名：	聯絡電話：	
	E-mail：		

參、計畫內容說明(多年期計畫應分年列述)

一、申請科技部計畫與企業合作計畫內容之研究重點

填寫說明：建議分別概述科技部補助部份與業界出資合作部份之研發內容，前者研發內容應較後者更具前瞻性；建議列述預期的研發標的與技術指標，應明確區別科技部補助部份與業界出資合作部份之預期成果

二、申請科技部計畫與企業合作計畫內容之關聯性

填寫說明：請說明科技部補助部份與業界出資合作部份研發內容之關聯性

